

半導體研習課程

半導體元件製程實作與 產業局勢分析

課程時間/地點

報名對象

第一梯次:

114/1/4(六)、1/5(日)、1/11(六)、1/12(日)、1/18(六)

1/20(一)~1/24(五) 共計10天

早上9:00~下午17:00

涵青館2樓以及半導體系館半導體元件製造中心

技職校院專業科目
技術科目教師

專業及技術人員或
專業及技術教師

聯絡窗口:龍華科技大學半導體工程系.張勤煜老師

聯絡電話:02-82093211#5217

電子信箱:cyc@mail.lhu.edu.tw

開放報名時間:

即日起至114年1月3日中午12:00為止

報名網址:<https://reurl.cc/M6yK7v>



報名QRcode

龍華科技大學113學年度教師產業研習 半導體技術研習課程

課程簡介

本研習課程共規劃4個課程單元，分別為「半導體產業局勢分析與環境永續趨勢」、「半導體元件製程實作」、「半導體封裝測試實作」與「企業參訪」

希望透過此研習課程，讓參與研習教師，對於半導體技術，能有更全面，進一步地瞭解。

課程時間

第一梯次:

114/1/4(六)、1/5(日)、1/11(六)、1/12(日)、1/18(六)、
1/20(一)~1/24(五) 共計10天

研習地點

龍華科技大學(桃園市龜山區萬壽路一段300號)
涵青館2樓以及半導體系館半導體元件製造中心

研習人數

每梯次15位額滿為止(本校教師最多10位)

研習對象

若全程出席將可獲得計10天，共70小時研習證書
若有部分時間衝突，可與計劃主持人聯絡討論

報名時間

即日起至114年1月3日中午12:00為止

報名網址:<https://reurl.cc/M6yK7v>

聯絡資訊

計劃主持人:龍華科技大學半導體工程系.張勤煜老師

聯絡電話:02-82093211#5217 電子信箱:cyc@mail.lhu.edu.tw



報名QRcode

113學年度第一梯次-課程及時間表

日期/時間	課程議題	日期/時間	課程議題
1/4 (六) 09:00-12:00	半導體產業局勢分析 (一)	1/20 (一) 09:00-12:00	半導體封裝測試介紹與實作 (一)
1/4 (六) 13:00-17:00	半導體產業局勢分析 (二)	1/20 (一) 13:00-17:00	半導體封裝測試介紹與實作 (二)
1/5 (日) 09:00-12:00	ESG環境永續趨勢 (一)	1/21 (二) 09:00-12:00	半導體封裝測試介紹與實作 (三)
1/5 (日) 13:00-17:00	ESG環境永續趨勢 (二)	1/21 (二) 13:00-17:00	半導體封裝測試介紹與實作 (四)
1/11 (六) 09:00-12:00	半導體元件製程介紹與實作 (一)	1/22 (三) 09:00-12:00	半導體封裝測試介紹與實作 (五)
1/11 (六) 13:00-17:00	半導體元件製程介紹與實作 (二)	1/22 (三) 13:00-17:00	半導體封裝測試介紹與實作 (六)
1/12 (日) 09:00-12:00	半導體元件製程介紹與實作 (三)	1/23 (四) 09:00-12:00	半導體封裝測試介紹與實作 (七)
1/12 (日) 13:00-17:00	半導體元件製程介紹與實作 (四)	1/23 (四) 13:00-17:00	半導體封裝測試介紹與實作 (八)
1/18 (六) 09:00-12:00	半導體元件製程介紹與實作 (五)	1/24 (五) 09:00-12:00	企業參訪
1/18 (六) 13:00-17:00	半導體元件製程介紹與實作 (六)	1/24 (五) 13:00-17:00	企業參訪